課題番号:F-14-OS-0034, S-14-OS-0021

利用形態 :技術代行

利用課題名(日本語) :新規ナノモールドの開発

Program Title (English) : The development of new nano-etching pattern on large area Si substrate

利用者名(日本語) :<u>佐藤数行</u> Username (English) :<u>K. Satoh</u>

所属名(日本語) :大阪大学-ダイキン共同研究講座

Affiliation (English) :Osaka University – DAIKIN collaborative research section

### 1. 概要(Summary)

ナノモールドに関して、これまで大面積化が作製困難であることが指摘されており、実用化がほとんどなされていない。今回、大面積なナノモールドを作製することを目的とする。

## 2. 実験 (Experimental)

・使用装置および作製サンプルの形態:

Fig.1 に示すように、短冊状にカットしたシリコン(Si)ウエハー基板上にナノピラーのエッチングパターン(4mm角)を電子線描画装置(エリオニクス製 ELS-7500EX)、および深堀エッチング装置(サムコ製 RIE-400iPB-NP)にて作製した。

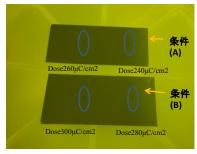


Fig.1 Sample of Si etching pattern.

#### ・サンプル処理方法:

今回、直径:230nm、深さ:200nm、ピッチ:460nm ハニカム状(交互)、ピラー:凸型

を大面積(4 inch size [φ120mm])で得ることを目的に、電子線リソグラフィー後に、大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点にてクロムを約 30nm 蒸着した。その後、リフティングオフしてエッチングパターンサンプルを作製し、その表面およびチルト像を SEM 観察にて行った。

# 3. 結果と考察 (Results and Discussion)

・SEM 観察の結果

エッチング条件 (A) (B) は、Fig.2 に示すような CAD パターンを  $100 \times 2400 \mu m$  の大きさにリフティン

グオフして行った。リフティングオフ後に、このクロム 基材をマスクとして深堀エッチングを行った。

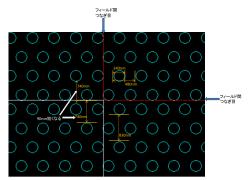


Fig.2 CAD pattern image.

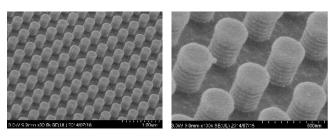


Fig.3 SEM image of Si nano-etching pattern.

エッチング条件 (A) (B) でエッチングした後の表面をSEMにて観察した (Fig.3)。その結果、Si 側壁面にスキャロッピングがあるものの、およそ目的とするナノパターンからなるサンプルが得られた。

# 4. その他・特記事項 (Others)

・技術支援者:柏倉美紀(大阪大学ナノテクノロジー 設備供用拠点)

# 5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) なし

### 6. 関連特許 (Patent)

なし